

证券代码：605358

证券简称：立昂微

杭州立昂微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-006

| | |
|----------------|---|
| 投资者关系 活动类别 | 业绩说明会 |
| 活动主题 | 立昂微 2025 年半年度业绩说明会 |
| 时间 | 2025 年 9 月 17 日 13:00-14:00 |
| 地 点 / 方 式 | 上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com 网络文字互动 |
| 上市公司接 待人员姓名 | 董事长：王敏文 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：吴能云 独立董事：吴仲时 副总经理：汪耀祖 |
| 投资者关系 活动记录 | <p style="text-align: center;">投资者关系活动主要内容</p> <p>1、请问立昂东芯与臻雷、铖昌是否还有合作？</p> <p> 副总经理汪耀祖答:尊敬的投资者：您好，感谢您对公司的关注。立昂东芯的 pHEMT、BiHEMT 等芯片产品已进入航空航天、防卫市场、低轨卫星等领域，具体客户请以公司信息披露为准，谢谢。</p> <p>2、请问第三季度目前各个板块的订单量与产能利用率如何？</p> <p> 董事长王敏文答:尊敬的投资者：您好，感谢您对公司的关注。公司第三季度的经营情况请以公司未来披露的定期报告为准，谢谢。</p> <p>3、请问一张 vsceI 硅片，大致可以分割为多少个晶圆？</p> <p> 副总经理汪耀祖答:尊敬的投资者：您好，感谢您对公司的关注。一张 VCSEL 晶圆根据产品应用场景的区别可以分割成数百个至数万个不等的管芯，谢谢。</p> <p>4、请问目前 12 寸硅片的良率如何？</p> <p> 董事长王敏文答:尊敬的投资者：您好，感谢您对公司的关注。半导体硅片公司的良率属于商业秘密，谢谢。</p> <p>5、6 英寸碳化硅基氮化镓产品通过客户验证，是应用于哪个行业的呢？军用还是民用？</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>副总经理汪耀祖答:尊敬的投资者:您好,感谢您对公司的关注。6英寸碳化硅基氮化镓芯片产品主要应用于大型通讯基站等领域,谢谢。</p> <p>6、请问功率板块目前的价格是否已经企稳?是否后续还需在存货中进行计提?</p> <p>董事长王敏文答:尊敬的投资者:您好,感谢您对公司的关注。目前功率器件芯片的价格已经企稳,公司将继续严格按照会计准则的规定进行财务处理,谢谢。</p> <p>7、请问贵公司一直提及6、8英寸硅片的订单饱满,但是为何在业绩上一直未曾体现?是销量高而价格降低所致吗?</p> <p>董事长王敏文答:尊敬的投资者:您好,感谢您对本公司的关注。上半年公司硅片业务板块营业收入同比、环比均有大幅增长,上半年半导体硅片实现主营业务收入125,892.50万元(含对立昂微母公司的销售14,344.39万元),相比上年同期增长23.21%。从销售数量来看,折合6英寸的销量为927.86万片(含对立昂微母公司的销售117.62万片),较上年同期增长38.72%,谢谢。</p> <p>8、请问贵公司功率板块业务中汽车行业和光伏行业的占比目前分别是多少?</p> <p>董事长王敏文答:尊敬的投资者:您好,感谢您对本公司的关注。公司功率板块业务的具体情况请以公司信息披露为准,谢谢。</p> <p>9、请问目前立昂东芯的产能利用率是多少?其中商业航天行业的芯片订单与产量如何?后续考虑如何提高产能利用率?</p> <p>副总经理汪耀祖答:尊敬的投资者:您好,感谢您对本公司的关注。立昂东芯的产能利用率正在快速爬坡中,低轨卫星使用的产品已大规模出货。立昂东芯的技术包括HBT、pHEMT、BiHEMT、VCSEL、碳化硅基氮化镓等,HBT芯片已进入国内外主流手机终端品牌,实现核心客户全覆盖及国产替代;pHEMT、BiHEMT芯片已进入航空航天、防卫市场、低轨卫星领域;VCSEL芯片凭借高精度、低功耗及车规级可靠性优势,成功切入高阶智能辅助驾驶与机器人核心供应链,成为车载激光雷达、机器人、无人机、光通信等场景的关键组件,公司成为全球唯二可生产二维可寻址激光雷达VCSEL芯片制造的供应商,技术领先同行;6英寸碳化硅基氮化镓产品通过客户验证,下半年将实现出货。随着系列产品应用场景不断拓展,公司将不断加强市场营销、发挥技术优势、满足客户需求,不断提高产能利用率。谢谢</p> <p>10、母公司的产品主要是什么,为什么连续2年亏损?今年母公司上半年现金流为负,原因是什么?立昂东芯今年上半年比去年答复亏损的原因是什么?嘉兴金瑞泓去年</p> |
|--|--|

| | |
|-----------------|--|
| | <p>上半年亏损 8701 万元，今年上半年利润是多少？谢谢</p> <p>答：尊敬的投资者：您好，感谢您对本公司的关注。母公司的主要产品为功率半导体芯片，亏损的主要原因系计提可转债的财务费用。母公司上半年经营性现金流为负数主要系母公司上半年预付子公司硅片采购款及收到的政府补助同比减少导致。立昂东芯2025年上半年同比利润下降主要系因产品工艺使用黄金价格的上涨，叠加因调整产品销售结构带来的阶段性产品销量的下降导致产品单位成本增加、毛利率下降，此外杭州立昂东芯子公司海宁立昂东芯增加项目借款导致财务费用大幅增加。嘉兴金瑞泓的半年度具体财务数据属于未公开信息不方便回答，谢谢。</p> <p>11、公司生产电阻率<1mohm 的重掺外延产品，占比多少？有多大产能？有哪些客户？毛利率如何？</p> <p>尊敬的投资者：您好，感谢您对本公司的关注。低电阻率重掺外延片产品为公司优势产品，具体产品规格、客户、毛利率等属于公司商业秘密，谢谢。</p> |
| 资 料 清 单 (如有) | 无 |